УДК 535.37

МЕХАНИЗМЫ НАРАБОТКИ ОСНОВНЫХ ДОЛГОЖИВУЩИХ ДЕФЕКТОВ В ЧИСТЫХ КВАРЦЕВЫХ СТЕКЛАХ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

А. П. Сергеев, П. Б. Сергеев

На основе анализа зависимостей амплитуд индивидуальных полос поглощения в кварцевых стеклах от флюенса электронного пучка (ЭП) выявлены механизмы наработки основных дефектов в стеклах типа КС-4В, КУ-1 и Корнинг 7980 при их длительном облучении импульсами ЭП.

Ключевые слова: кварцевые стекла, КС-4В, КУ-1, электронный пучок, спектры поглощения, индивидуальные полосы, долгоживущие дефекты.

В электронно-пучковых эксимерных лазерах (ЭПЛ) выходные окна подвергаются воздействию рентгеновского излучения и рассеянных из пучка накачки быстрых электронов [1–4]. Под действием этих ионизирующих излучений в материале лазерных окон нарастает поглощение, что может ограничивать их работоспособность [5, 6]. Кварцевые стекла, предназначенные для работы с УФ-излучением, являются основным материалом для крупных окон мощных технологических ЭПЛ. Это и определило необходимость и направленность экспериментального изучения изменений в поглощении кварцевых стекол типа КС–4В, КУ–1 и Корнинг 7980 при длительном воздействии импульсов электронного пучка (ЭП) и УФ-лазерного излучения [7–10].

Применение метода разложения сложных спектров на индивидуальные полосы (ИП) [11] при анализе полученных в экспериментах [7–10] спектров наведенной оптической плотности кварцевых стекол позволило установить, что эти спектры в области ~160– 350 нм состоят из шести ИП [10]. В [12, 13] были получены зависимости амплитуд этих шести полос (A_i) от суммарной плотности энергии ЭП за серию импульсов (далее просто флюенса ЭП – F). Индекс *i* у A_i указывает на номер ИП в табл. 1 из [10], где даны параметры полос и произведена их привязка к поглощающим центрам. Из табл. 1 в [10] следует, что полоса с индексом 1 и максимумом поглощения на 260 нм принадлежит немостиковым атомам кислорода (НАК). Полоса с индексом 4 и максимумом на 213 нм

ФИАН, 119991 Россия, Москва, Ленинский пр-т, 53; e-mail: psergeev@sci.lebedev.ru.

принадлежит *E'*-центрам. Шестая полоса с максимумом на 163.5 нм приписывается кислороддефицитным центрам (КДЦ). Эта индексация будет использована и здесь.

Таблица 1

Марка	Тип	$N_{\rm im} \cdot 10^{-16},$	$n_{\rm im} \cdot 10^{-18},$	$F_{\rm im}$,	$D_{\rm im},$	$\varepsilon_i \cdot 10^{13}$,
стекла	дефекта	CM^{-2}	cm^{-3}	$Дж/см^2$	МΓр	Дж
KC–4B	HAK $(i=1)$	2	1	1500	34	0.8
КУ-1	HAK $(i=1)$	10	5	1000	23	0.1
C–ArF	HAK $(i=1)$	6	3	1000	23	0.2
KC–4B	E'-центр $(i = 4)$	1.2	0.6	1500	34	1.2
КУ-1	E'-центр $(i = 4)$	4	2	1500	34	0.4
C–ArF	E'-центр $(i = 4)$	2	1	1000	23	0.5
KC–4B	КДЦ $(i=6)$	3.3	1.6	4000	91	1.2
КУ-1	КДЦ $(i=6)$	3.3	1.6	4000	91	1.2
C–ArF	КДЦ $(i = 6)$	_	_	_		~ 1

Ключевые характеристики наработки основных дефектов кварцевых стекол при облучении электронным пучком

По поводу приведенных типов дефектов из табл. 1 в [10] отметим следующее. Спектры наведенного ЭП поглощения регистрировались, в основном, примерно через сутки после облучения. Следовательно, соответствующие ИП и их характеристики принадлежат ансамблям долгоживущих дефектов кварцевых стекол, сформировавшимся к этому времени. Последующие времена жизни (τ_i) этих групп дефектов при температурах хранения около 0 °C и отсутствии световой подсветки достигают 10⁸ с и более [8].

Выявление возможных механизмов наработки именно таких ансамблей основных дефектов (НАК, E'-центров, КДЦ) в кварцевых стеклах при их облучении импульсами ЭП с энергией электронов до 300 кэВ и было целью данной работы. Для этого использованы экспериментальные зависимости $A_i(F)$, полученные для стекол типа KC-4B, KV-1 и Corning 7980 ArF Grade (далее C-ArF) [12, 13].

Выбор этой основной тройки дефектов обусловлен тем, что в чистых кварцевых стеклах именно они определяют наведенное поглощение в УФ-области спектра, их природа ясна, и для них известны сечения поглощения (σ_i) [14–16]. А знание σ_i позволяет произвести важнейший для количественных оценок переход от величин A_i к величинам поверхностной плотности дефектов N_i (интеграл от плотности дефектов по толщине образца) на основе соотношения:

$$N_i = A_i / \sigma_i. \tag{1}$$

Описать похожие у всех стекол зависимости $A_i(F)$, а, значит, и $N_i(F)$, выходящие на стационарный уровень с ростом F [12, 13], можно с помощью простейшей функции:

$$N_i = N_{\rm im} [1 - \exp(-F/F_{\rm im})].$$
(2)

Она является решением дифференциального уравнения

$$dN_i/dF = (N_{\rm im}/F_{\rm im}) - N_i/F_{\rm im}.$$
(2a)

Здесь $N_{\rm im}$ – величина стационарного количества *i*-тых дефектов, $F_{\rm im}$ – характеристика скорости их выхода на максимальный уровень. Данные параметры позволяют рассчитать третью величину ($N_{\rm im}/F_{\rm im}$), определяющую скорость нарастания количества дефектов в начале облучения, связанную с энергией образования соответствующих дефектов (ε_i) соотношением

$$\varepsilon_i = (N_{\rm im}/F_{\rm im})^{-1}.\tag{3}$$

Заметим, что уравнение (2а), по сути, является уравнением кинетики для N_i , т.к. величина F есть линейная функция от времени облучения образцов $t: F = W_s \cdot t$. Здесь W_s есть средняя удельная мощность ЭП, равная произведению флюенса ЭП за импульс (F_1) на среднюю частоту следования импульсов f. С учетом этой связи F и t достаточно умножить все члены уравнения (2а) на W_s , чтобы получить уравнение кинетики для N_i :

$$dN_i/dt = (N_{\rm im}/\tau_{\rm im}) - N_i/\tau_{\rm im}.$$
(2b)

Здесь величина $\tau_{\rm im} = F_{\rm im}/W_s$. Исходя из детально описанных в [7–10, 12, 13] условий облучения образцов, флюенс ЭП в 1000 Дж/см² достигается примерно за 10⁶ с.

Знание величины $N_{\rm im}$ и предположение, что вид распределения концентрации дефектов (n_i) по толщине образца (x) повторяет вид распределения поглощенной дозы D(x), который близок к прямоугольному [12], позволяет оценить максимальную концентрацию соответствующих дефектов $(n_{\rm im})$ на основе выражения:

$$n_{\rm im} = N_{\rm im}/L_0. \tag{4}$$

Здесь L_0 есть эффективная толщина облучения стекол электронным пучком, определяемая из предположения равномерного распределения поглощенной дозы по толщине образца с плотностью $\rho = 2.2 \ \text{г/см}^3$ с максимальным уровнем дозы у поверхности D(0) при флюенсе ЭП за импульс F_1 :

$$L_0 = F_1 / D(0)\rho. (5)$$

При $F_1 \approx 2$ Дж/см² величина $D(0) \approx 40$ кГр, а $L_0 \approx 0.02$ см [12].

Приближение прямоугольного распределения поглощенной дозы на глубине L_0 дает возможность перевести величины $F_{\rm im}$ в дозовые значения $(D_{\rm im})$ на основе соотношения

$$D_{\rm im} = F_{\rm im} / (L_0 \cdot \rho). \tag{6}$$

Величины $N_{\rm im}$, $n_{\rm im}$, $F_{\rm im}$, $D_{\rm im}$ и ε_i , найденные соответствующим образом из экспериментальных зависимостей $A_i(F)$ [12, 13] с учетом (1)–(6), для кварцевых стекол КС–4В, KV–1 и Corning 7980 ArF Grade (C–ArF) представлены в соответствующих колонках табл. 1. При расчете $N_{\rm im}$ использовались следующие значения сечений поглощения: $\sigma_1 = 5.3 \cdot 10^{-18}$; $\sigma_4 = 2.5 \cdot 10^{-17}$; $\sigma_6 = 7.5 \cdot 10^{-17}$ см². Возможная неточность этих величин может достигать 30% [14–16].

Выход N_i на постоянный уровень с ростом F, а значит и временем облучения t, может быть обусловлен разными причинами. Рассмотрим два типичных случая, которые связаны с двумя принципиально разными механизмами наработки дефектов.

Первый предполагает, что рост количества дефектов со временем компенсируется их релаксацией. Этот случай описывается хорошо известным уравнением кинетики для концентрации дефектов *n*:

$$dn/dt = W - n/\tau. \tag{7}$$

Здесь au – время жизни дефектов, W – скорость их наработки, которая пропорциональна мощности облучения. При постоянстве этих величин концентрация дефектов выходит со временем на стационарный уровень ($n_m = (W \cdot \tau)$) по закону:

$$n = (W \cdot \tau)[1 - \exp(-t/\tau)]. \tag{7a}$$

Второй случай предполагает, что дефекты образуются из неких "предшественников", концентрация которых ограничена и, предположим, равна *p*. В этом случае уравнение для концентрации дефектов можно представить в виде:

$$dn/dt = A(p-n) - n/\tau.$$
(8)

14

Здесь A есть коэффициент, характеризующий скорость превращения "предшественников" в дефекты. Он пропорционален мощности облучения. После простейшего преобразования уравнение (8) принимает следующий вид:

$$dn/dt = Ap - n(A + 1/\tau).$$
(8a)

Оно тождественно (7), но с другими коэффициентами. Его решение имеет вид:

$$n = [(Ap)/(A+1/\tau)] \cdot [1 - \exp(-t(A+1/\tau)].$$
(8b)

Если $A >> 1/\tau$, то (8b) упрощается:

$$n = p[1 - \exp(-tA)]. \tag{8c}$$

Сравнение (8b) и (7a) показывает, что в обоих случаях выход на стационарный уровень описывается одной и той же функцией. При этом во втором случае стационарная концентрация дефектов приближается к концентрации "предшественников" и, что важно, слабо зависит от мощности облучения. Кроме этого, в экспоненте к величине $1/\tau$ во втором случае добавляется еще и скорость выгорания "предшественников" (A). Иногда, как в случае (8c), эта скорость может полностью определять время выхода на стационар. Значит, при интерпретации данных, получаемых из практически одинаковых по форме зависимостей $N_i(F)$, важно четко определиться с видом процесса наработки дефектов.

Для этого обратим внимание на следующий экспериментальный результат. Облучение образцов стекол КУ–1 и КС–4В импульсами ЭП проводилось одновременно в трех разных режимах. В первом режиме образцы прикрывались слоем титановой фольги толщиной 14–28 мкм, а F_1 был около 2 Дж/см². Во втором режиме толщина титановых фольг менялась в пределах 50–100 мкм, а F_1 – от 0.3 до 0.9 Дж/см². В третьем режиме толщина фольги была около 140 мкм, а $F_1 \sim 0.1$ Дж/см² [7–8, 12, 13]. При этом изменялась и средняя энергия ЭП: около 300 кэВ для первого режима, ~100 кэВ для второго и не выше 50 кэВ для третьего.

Эксперименты показали [7], что у стекла КУ–1 уровень стационарной оптической плотности на 250 и 215 нм практически линейно нарастает с F_1 , а у образцов КС–4В при облучении в первом и втором режимах он был практически одинаков. Результаты по третьему режиму здесь не рассматриваем из-за того, что стационарный уровень при нем не достигался. Так как частота следования импульсов ЭП f в этих экспериментах была для всех режимов одинакова, то рост F_1 отражает рост средней мощности облучения. Отсюда следует, что в КУ–1 рост количества НАК и E'-центров можно описывать уравнением (7), а у КС-4В реализуется второй случай образования этих дефектов из "предшественников".

Экспериментальные зависимости $N_6(F)$ у КУ–1 и КС–4В практически совпадают и, что важно, при разных режимах облучения [12, 13]. Это указывает на применимость и к их интерпретации второго подхода. При этом время жизни у КДЦ значительно выше, чем у НАК и E'-центров, что оправдывает применимость уравнения (8с).

Утверждение, что в стекле КС–4В наработка основных дефектов происходит из "предшественников", ставит вопрос об их природе. В качестве таковых при образовании первичных НАК и E'-центров в этом стекле могут выступать "растянутые" связи, а наработка КДЦ объясняется локализацией дырок на "сжатых" связях [13]. Следовательно, приводимые в табл. 1 значения n_{mi} у этого стекла показывают уровень концентрации соответствующих "предшественников".

Образование НАК и E'-центров по каналу разрыва "растянутых" связей в КС–4В должно приводить к одинаковому количеству этих дефектов, что не совпадает с данными из табл. 1. Эти различия могут быть связаны с релаксационными процессами. Напомним, что облучение образцов импульсами ЭП длилось около года [7, 8]. Превышение числа НАК над E'-центрами можно объяснить взаимодействием первичных дефектов с междоузельным кислородом, появляющимся в процессе образования КДЦ. Действительно, при одинаковых скоростях взаимодействия кислорода в реакциях

$$\equiv SiO(HAK) + O \rightarrow \equiv SiOO(пероксирадикал);$$
(9a)

$$\equiv Si(E' - \text{центр}) + O \rightarrow \equiv SiO(\text{HAK})$$
(9b)

количество E'-центров уменьшится, а число НАК останется прежним, т.к. их убывание в результате первой реакции компенсируется притоком по второй. Оценки, проведенные с учетом количества атомов кислорода, выброшенных в междоузлия при образовании КДЦ к моменту выхода на стационарный уровень, количества НАК и E'-центров ($F \approx 4 \text{ кДж/см}^2$), показывают, что данный механизм с хорошей точностью объясняет наблюдаемое неравенство наработки основной пары дефектов. Отсюда же следует, что именно число НАК у КС–4В в колонке для $n_{\rm im}$ табл. 1 наиболее точно отражает уровень "растянутых" связей в этом стекле.

КДЦ, образовавшиеся в стеклах КС–4В и КУ–1 при электронном облучении, очень устойчивы. После облучения ЭП их количество в образцах практически не менялось в течение четырех лет хранения. Облучение этих же образцов излучением ArF-лазера также не вызывало изменения количества КДЦ [10]. Следовательно, значения n_{6m} в табл. 1 отражают уровень "предшественников" КДЦ, которыми могут быть "сжатые" связи [13].

Близость энергий образования НАК и КДЦ у КС-4В указывает на близость уровней концентрации их "предшественников" – "растянутых" и "сжатых" связей, и одинаковость механизмов стимуляции их превращений. В обоих случаях это локализация на них дырки.

Как видно в табл. 1, количество КДЩ у КС–4В и КУ–1 в режиме насыщения совпадает. Значит, должны совпадать и концентрации их "предшественников" – "сжатых" связей. Они, как известно, определяются температурой стеклования [17]. Но это же относится и к "растянутым" связям, т.е. их количество в КУ–1 такое же, как в КС–4В. Тогда наработка НАК и *E'*-центров через разрыв "растянутых" связей в КУ–1 производит такое же количество этих дефектов, как и в КС–4В. В единицах концентрации это около 10¹⁸ см⁻³, что составляет до 20% от всего количества НАК в КУ–1 и до 50% *E'*-центров.

Из столбца для ε_i в табл. 1 видно, что энергии образования НАК во "влажных" стеклах КУ–1 и C–ArF с содержанием гидроксила ~1000 ppm близки, но значительно меньше, чем аналогичная энергия у КС–4В, которое относится к группе "сухих" стекол с содержанием гидроксила менее 1 ppm. Следовательно, у "влажных" стекол при электронном облучении есть дополнительные и эффективные механизмы наработки НАК.

В первую очередь, это отрыв H у комплекса \equiv SiOH, о чем говорилось ранее [10, 12, 13]. Концентрация таких комплексов у наших "влажных" стекол составляет ~ 10^{20} см⁻³. Но образование долгоживущих комплексов \equiv SiO, т.е. НАК, в первую очередь, возможно при отсутствии обратного процесса. Его устранение происходит при связывании свободных атомов водорода на междоузельном кислороде или хлоре. Поэтому концентрация этих газов в междоузлии и будет определять число НАК, образовавшихся в этом процессе [10]. Если каждый атом кислорода в междоузлии связывает два атома водорода, а О здесь появляется столько же, сколько КДЦ у КС–4В, то за счет этого процесса НАК в КУ–1 образуется ~ $3 \cdot 10^{18}$ см⁻³ или ~60% от их полного числа.

Отрыв H у комплекса \equiv SiOH может приводить к наработке основной пары дефектов и при наличии обратного процесса. Так, если оторванный атом H не вернется на старое место, а свяжется с HAK короткоживущей комплиментарной пары, образовавшейся при разрыве регулярной \equiv Si-O-Si \equiv связи, то произойдет пространственное разделение первичных HAK и E'-центра, что переводит их в разряд долгоживущих [10]. Оценки показывают, что по этому третьему каналу в KУ-1 нарабатывается до 10¹⁸ см⁻³ HAK и Е'-центров, что составляет примерно 20 и 50% от их общего количества.

По паспортным данным, содержание хлора у стекол Corning 7980 типа Base Grade, KrF Grade и ArF Grade составляет ~100, 50 и 20 ppm соответственно при одинаковом содержании гидроксила на уровне 800–1000 ppm. Наведенная оптическая плотность в УФ-диапазоне у этой группы стекол в режиме насыщения различалась всего лишь на 10% [8]. Из этого следует, что наблюдаемые различия в поглощении у стекол KV–1 и С–ArF обусловлены не столько различиями в содержании Cl, сколько в содержании гидроксила. Напомним, что в KV–1 его количество составляет от 1000 до 2000 ppm.

Результаты, приведенные в колонках $F_{\rm im}$ и $D_{\rm im}$ в табл. 1, отражают скорости выхода количества соответствующих дефектов на стационарный уровень, который достигается примерно при $3F_{\rm im}$. В стекле КС–4В скорость наработки НАК и E'-центров определяется скоростью выгорания "растянутых" связей и, естественно, она одинакова у обоих дефектов. Доминирование различных каналов наработки этих дефектов во "влажных" стеклах определяет и различие скоростей их выхода на стационарный уровень. Меньшая скорость образования КДЦ в КС–4В и КУ–1, чем скорость наработки НАК, может объясняться почти в 3 раза меньшей квантовой эффективностью процессов, протекающих при локализации дырок на "сжатых" связях.

Таким образом, проведенный в данной работе анализ зависимостей амплитуд ИП, принадлежащих основным дефектам кварцевых стекол, от флюенса ЭП позволил выявить различия в процессах дефектообразования у них. У высокочистого кварцевого стекла КС-4В основным механизмом создания НАК и *E'*-центров является разрыв "растянутых" связей при локализации дырок на них. Аналогичный процесс на "сжатых" связях ведет к образованию КДЦ и выбросу атомов кислорода в междоузлие. Их взаимодействие с НАК и *E'*-центрами приводит к уменьшению концентрации последних и появлению новых дефектов, в частности, пероксирадикалов, поглощающих, по всей видимости, в полосе на 183 нм. Во "влажных" стеклах с высоким содержанием гидроксила (КУ-1 и C-ArF) на процессы, происходящие при разрыве "напряженных" связей, описанных выше, накладываются процессы наработки НАК при отрыве водорода от гидроксильной группы, а также взаимодействие выбрасываемых в междоузлия атомов водорода с кислородом и короткоживущими НАК. Эти процессы ведут к повышению выхода долгоживущих НАК у исследованных стекол от 3 до 5 раз, а *E'*-центров до 2 раз.

Полученные результаты показывают, что среди изученных кварцевых стекол наименьшим уровнем наведенного электронным пучком стационарного поглощения в индивидуальных полосах, принадлежащих НАК и E'-центрам, обладает высокочистое "сухое" стекло КС–4В. Выявление механизмов образования радиационных дефектов в этом стекле указывает на возможные пути дальнейшего повышения его радиационной прочности: надо искать способы снижения количества "напряженных" связей. В частности, это может быть и их отжиг светом ВУФ диапазона или рентгеновским излучением в присутствии водорода, воды, метана или других газов в междоузлиях стекла для перевода возникающих при облучении НАК и E'-центров в ≡SiOH комплексы.

ЛИТЕРАТУРА

- B. С. Барабанов, Н. В. Морозов, П. Б. Сергеев, Квантовая электроника 18, 1364 (1991).
- [2] V. S. Barabanov, N. V. Morozov, P. B. Sergeev, J. of Soviet Laser Research 14(4), 286 (1993).
- [3] А. В. Амосов, В. С. Барабанов, С. Ю. Герасимов и др., Квантовая электроника 20, 1077 (1993).
- [4] В. С. Барабанов, П. Б. Сергеев, Квантовая электроника 22, 745 (1995).
- [5] V. G. Bakaev, E. V. Polyakov, G. V. Sychugov, et al., Proc. SPIE **5137**, 323 (2003).
- [6] I. A. Mironov, V. M. Reiterov, A. P. Sergeev, et al., Proc. SPIE 5479, 135 (2004).
- [7] П. Б. Сергеев, Т. А. Ермоленко, И. К. Евлампиев и др., Оптический журнал 71(6), 93 (2004).
- [8] П. Б. Сергеев, А. П. Сергеев, В. Д. Зворыкин, Квантовая электроника 37, 706 (2007).
- [9] П. Б. Сергеев, А. П. Сергеев, В. Д. Зворыкин, Квантовая электроника 37, 711 (2007).
- [10] П. Б. Сергеев, А. П. Сергеев, Квантовая электроника 40, 804 (2010).
- [11] М. В. Фок, Труды ФИАН **59**, 3 (1972).
- [12] А. П. Сергеев, П. Б. Сергеев, Оптический журнал 78(5), 77 (2011).
- [13] А. П. Сергеев, П. Б. Сергеев, Краткие сообщения по физике ФИАН 38(12), 21 (2011).
- [14] K. Saito, A. J. Ikushima, T. Kotani, T. Miura, J. Appl. Phys. 86, 3497 (1999).
- [15] L. Skuja, H. Hosono, M. Hirano, Proc. SPIE **4347**, 155 (2001).
- [16] K. Kajihara, M. Hirano, L. Skuja, H. Hosono, Phys. Rev. B 78, 094201 (2008).
- [17] K. Awazu, H. Kawazoe, J. Appl. Phys. **94**, 6243 (2003).

Поступила в редакцию 26 июня 2014 г.